

JAPAN

エスタカヤ電子工業（株）



岡山県浅口郡里庄町里見 3121-1
敷地面積：40,206㎡
工場建物面積：31,736㎡

エスタカヤ電子工業株式会社



社名	エスタカヤ電子工業株式会社
創立	1979年8月
代表者	代表取締役社長 柚木 太志
資本金	1億円
売上高	145.0億円 (2021年3月31日現在)
取扱内容	LSIデバイス・モジュール レーダーモジュール 開発商品製造・販売 環境商品販売
従業員数	523名 (2021年1月1日現在)

2021年 10月	社名をエスタカヤ電子工業(株)に変更
2020年 6月	資本金1億円に減資
2020年 3月	シャープ(株)保有の当社株40%を当社で買取
2019年 7月	レーダモジュールビジネス開始
2018年 9月	IATF16949 登録 (JQA : JQA-AU0293)
2018年 3月	SAIGON STEC 資本51%シャープ(株)へ譲渡
2015年 10月	ISO/TS16949 登録
2008年 8月	SAIGON STEC (海外生産拠点) 操業開始
2008年 8月	ISO9001 登録 (JQA : JQA-QMA13703)
2001年 10月	カメラモジュール生産開始
2000年 6月	資本金 3億1000万円へ増資
1999年 9月	ISO14001 登録 (JACO : EC99J1074)
1998年 11月	COF生産開始
1996年 8月	CSPプロセス生産開始
1992年 10月	CCDプロセス生産開始
1983年 4月	TCPプロセス生産開始
1981年 12月	ウエハーテスト開始
1980年 4月	IC LSI アセンブリ&テスト開始
1979年 8月	シャープ(株)の半導体事業の協力会社としてタカヤ(株)とシャープ(株)の共同出社によりシャープタカヤ電子工業(株)として設立 資本金 2億 5000万円

事業内容

LSIデバイス・モジュール

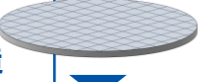
電子部品OEM / ODM

お客様から支給された半導体ウェハの加工・パッケージングを請け負います。
製品開発段階からの技術サポートに対応します。

LSI Device

お客様

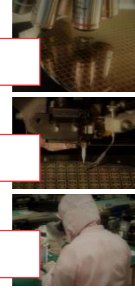
回路設計
ウェハ製造



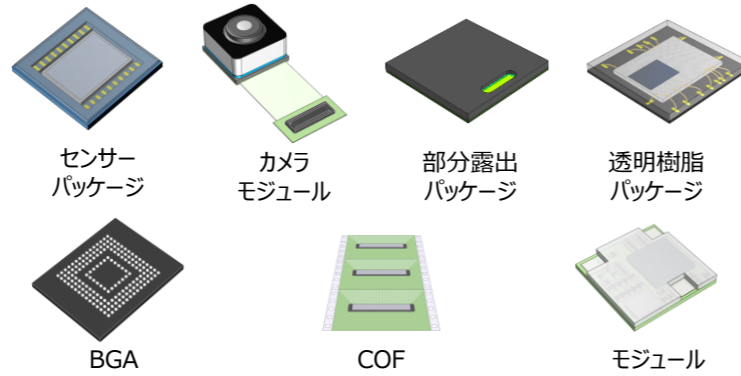
ウェハ加工

パッケージング

検査



パッケージング例



電子機器OEM / ODM

電子機器の組立を分野を問わず幅広く請け負います。
製品の特長に合わせた最適な組立ラインを構築します。

Electronic Device



各種信頼性試験

電子部品・電子機器の耐久性を評価する信頼試験を請け負います。

Reliability Test

- ・高温高湿試験
- ・温度サイクル試験
- ・プレッシャークッカー試験
- ・高温保存試験
- ・超低温保存試験
- ・振動試験
- ・落下衝撃試験



レーダーモジュール

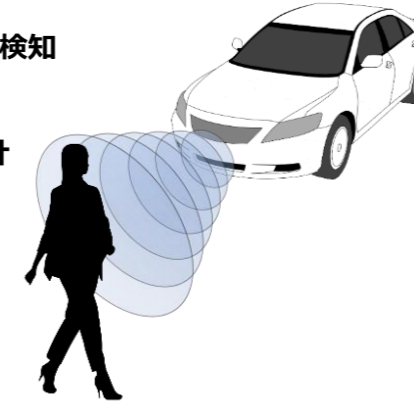
レーダー開発・製造

お客様の目的・環境に合わせてカスタマイズいたします。
独自開発のミリ波レーダー（デモ機）でまずは体験してください。

Millimeter-Wave Radar

ミリ波レーダー使用例

- ・自動車自動運転(ADAS)、乗員検知
- ・ドローン衝突検知、高度検知
- ・水位計、高度計、距離計、速度計
- ・トイレの人検知、水検知
- ・駐車場の自動車検知
- ・バイタルセンシング
- ・セキュリティ(人、物の検知)



評価キット



開発商品製造・販売

設備開発・製造

ものづくりの現場の自動化を実現するオリジナル設備を開発・製造します。
お客様が設計された設備の組立作業も請け負います。

Machinery Development

設備構想のご提案

要求仕様の摺り合わせ

開発・製造・組立

アフターサービス

設備開発例



カメラモジュール
全自動テスター



汎用ローダー/
アンローダー



レーザー
はんだ実装設備

環境商品販売

環境商品販売

太陽光発電システム関連商品のご提案・施工を承っています。
デジタルサイネージ機器のカスタム開発・製造を請け負います。

Environmental Products



デジタルサイネージ



家庭用太陽光発電システム



蓄電池（屋外用／屋内用）